PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

\$57-28320

(43) Date of publication

16 February 1982

(51) Int. Cl.

H01G 9/04

13/00

(21) Application number: S55-103373 (71) Applicant: SHIN NIPPON DENKI

(22) Date of filing: 28 July 1980

Co., Ltd.

(72) Inventors: Yasuhiko TSUDUKI

Kenji YAMANISHI

PRODUCTION METHOD OF A SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

Scope of claim

A production method of a solid electrolytic capacitor, wherein in the chemical reformation of a capacitor element made of a valve-acting metal member having an oxide layer and a semiconductor layer formed on the surface, the capacitor element is contacted with the chemical reformation solution which flows down on a conductive member by directly or almost contacting the inclined conductive member.

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

@ 公開特許公報 (A)

昭57-28320

①Int. Cl.³ H 01 G 9/04 13/00 識別記号

庁内整理番号 7924—5E 7216—5E 公開 昭和57年(1982)2月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

図固体電解コンデンサの製造方法

②特

願 · 昭55-103373

20出

頁 昭55(1980)7月28日

⑫発 明 者 都築康彦

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

@発 明 者 山西健二

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

⑪出 願 人 新日本電気株式会社

大阪市北区梅田1丁目8番17号

明 細 書

発明の名称

固体電解コンデンサの製造方法

特許請求の範囲

弁作用を有する金属部材にて構成され、かつその表面に較化層、半導体層の形成されたコンデンサエレメントを再化成処理するに際し、コンデンサエレメントを傾斜状態にある導電部材に当接ないし近接することによって導電部材に沿って流下する再化成液に接触させることを特徴とする固体電解コンデンサの製造方法。

発明の詳細な説明

本発明は固体電解コンデンサの製造方法に関し、 特に半導体層形成工程後に行われるコンデンサエ レメントの再化成処理に原因して発生する不良を 低減させることを目的とするものである。

一般に固体軍解コンデンサは例えば第1回化示

ところで、このコンデンサエレメントAの表面 には化成処理による誘電体としての酸化層 B が形 成され、さらにその上に二酸化マンガンなどの半 導体層 P が形成されているのであるが、特に半導 体層形成工程において、200~400 C の加熱 処理が行われることもあって、酸化層が劣化し 強度 C 施特性 などが損なわれる傾向にある。

・従って、従来においては例えば第2例に示すように、コンデンサエレメント A を再化成液に浸液

し、コンデンサエレメントA及び再化成液に、コンデンサエレメンドAがプラス,再化成液がマイナスとなるように直流電圧を印加することによって再化成処理が行われている。この処理によって大部分のコンデンサエレメンドAにおける酸化層とは修復され、品位の高いコンデンサを得ることができるものである。

との原因については、過大な電流が流れたコン

特定のコンデンサエレメントが不良になっても、 その周辺のコンデンサエレメントに対する悪影響 を値力軽減させうる固体電解コンデンサの製造方 法を提供するもので、以下にその一製造方法につ いて第3図~第4図を参照して説明する。

デンサエレメントAの周辺に位置するコンデンサエレメントAの外表面が黒褐色などに変色しているととから、半導体層ドとして用いている二酸化マンガンなどによりマンガンイオンなどが遊離して付着することによって特性劣化させているように考えられる。

通常、再化成町圧は酸化層をの工程劣化に関連して化成甲圧より低く設定しなければならないのであるが、化成町圧に近似させることができればできる程、良品として残存するコンデンサエレメントAの特性グレードは高くなり、好ましいものである。

しかし乍ら、上述のように多くのコンデンサネシにありには再化成処理中に不良にたる。 のがあり、これに原因してさらに多くの不良が発生することもあって、やむなく再化の電圧はそのような不良発生を極力抑制しうるような低い高いコンデンサを得ることが難しいという問題がある。 本発明はこのような点に鑑み、再化成処理時に

れたパイプタより再化破液10を導電部材8亿供 給する。すると、この再化成液10は導電部材8 **に沿って流下すると共に、それぞれのコンデンサ** エレメント1に接触し内部に含浸される。この状 態において、ホルダー3,導奪部材8に、ホルダ - 8がプラス,導電部材がマイナスとたるように 直流電圧を印加すると、それぞれのコンテンサエ レメント1は再化成される。そして、濃電部材8 に沿って流下した再化成液10は容器7の他方の 壁面りりに配設されたパイプ11によって排出さ れる。尚、この状態において、何らかの順因によ って特定のコンデンサエレメント1の酸化質5が 破綴され、過大な電流が流れた場合、半導体層の !として二酸化マンガンを用いていると、多量のマ ンガンイオンが遊離されるのであるが、再化破液 10の流下によって洗い流される関係で、周辺の コンデンサエレメントしに付着することはない。 以下、通常の方法によって固体電解コンデンサを 得る。

とのようにコンデンサエレメント」の再化破処

- 持開昭57- 28320 (3).

の特性グレードは大巾に改善できる。

しかも、これによって特性グレードを従来と同等程度に設定すれば、その分だけコンテンサェレメント 1 を構成する金属部材の使用量を節破でき、コストを低破できる。

理に際し、それぞれのコンデンサエレメント1に は薄電部材 8 に沿って流下する再化成液 1 0 が 位 ほ独立した状態で接触しているために、仮に特定 のコンデンサエレメント1 の不良に原因して多量 のマンガンが遊離しても直ちに洗い流されてしま う。 このために、マンガンイオンの周辺のコンデ ンサエレメント1 への付着を防止でき、特性劣化 も防止できる。

又、コンデンサエレメント1 に当接ないし近接 する薄質部材 8 を複数本並設すれば、導電部材 8 に沿って流下する再化 1 0 の 液量が増加する ために、上述のようにコンデンサエレメント 1 の 不良によって多量のマンガンイオンが遊離しても、 周辺のコンデンサエレメント 1 への付着を一階確 実に防止できる。

特に再化成配任を通常より高くすれば、再化成 処理時にいくらかのコンデンサエレメント1は不 良になるものの、それの周辺のコンデンサエレメ ント1に対する悪影響を防止できることもあって、 再化成処理に耐え抜いたコンデンサエレメント1

沿って流下すると共に、それぞれのコンデンサエレメントに接触し、内部に含浸される。との状態でコンデンサエレメントは再化成される。以下、通常の方法にて固体タンタル電解コンデンサを製作する。

このコンデンサの再化成工程における不良発生 率は下表に示す通りであった。

	本発明品	從來品
再化成電圧50%	U 3 1869	1.0 595
~ 70.96	. 0.8 (~)	4: 5 (*)

上表より明らかなように、本発明品は従来品に 比し、再化成電圧が高くても低くても不良発生率 す著しく減少している。 これは再化成処理時に発 主した不良による周辺のコンデンサエレメントへ の悪影響が始んでないことに原因している。

尚、本発明は何ら上記実施例にのみ制約されることなく、例えばコンデンサエレメントは金鳳粉 を所望形状に加圧成形する他、板材、線材など てて権成することもできる。又、準電部材は線材 の他、板材を用いることもできる。

以上のように本発明によれば、再化成処理時に特定のコンデンサエレメントが不良になっても、その周辺に位置するコンデンサエレメントに対する悪影響を効果的に軽減でき、コンデンサとしての品位を高めることができる。

図面の簡単な説明

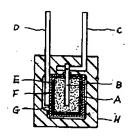
第1図は従来の関体貿解コンデンサの側断面図、第2図は再化成方法を説明するための側断面図、第3図〜第4図は本発明方法の説明図であって、第3図はコンデンサエレメントをホルダーに吊設した状態を示す側断面図、第4図は再化成方法を説明するための要部破断側面図である。

特許出願人

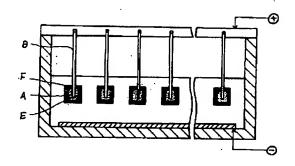
可日本電気株式会社

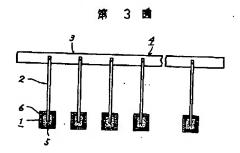


第1日

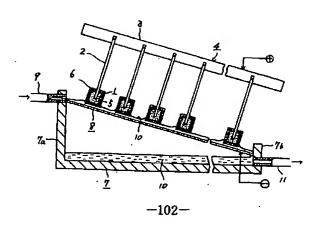


1* 2 🖾





馆 4 段



BEST AVAILABLE COPY